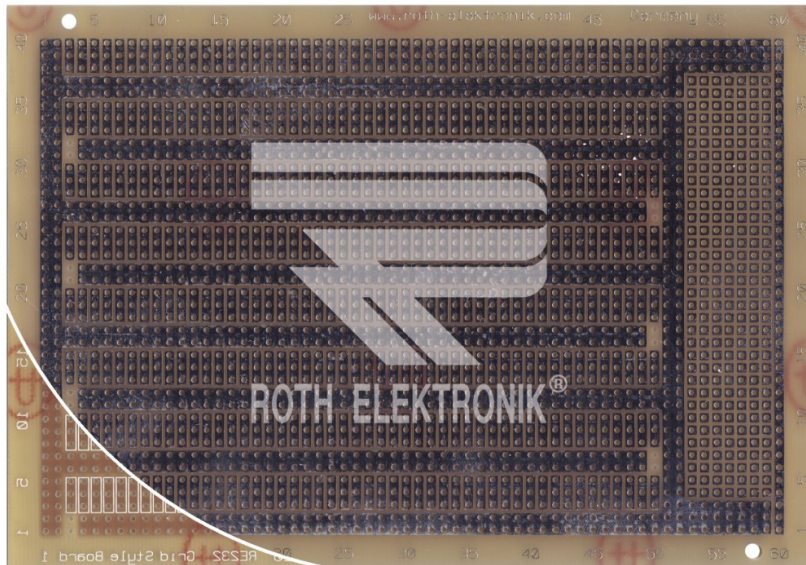


**Tarjeta experimental para DUAL INLINE ICs (no en Euro-formato)**



**RE232-LF**

- fibra de vidrio epoxídica FR4 de 1,60 mm, por un lado 35 µm de CU
- lado de soldadura estañado en caliente (HAL-leadfree)
- Impresión de dotación por el lado de los componentes eléctricos
- trama de agujeros 2,54 mm x 2,54 mm
- 40 x 60 hileras de agujeros
- nodos de soldadura de 3 agujeros
- 4 hileras DIP IC, trama de 7,62 mm, 15,24 mm con 48 conexiones
- diámetro de los agujeros 1,02 mm (0,40")
- temperatura máx. de servicio 150° C
- tamaño 114,30 mm x 165,10 mm (4,5" x 6,5")